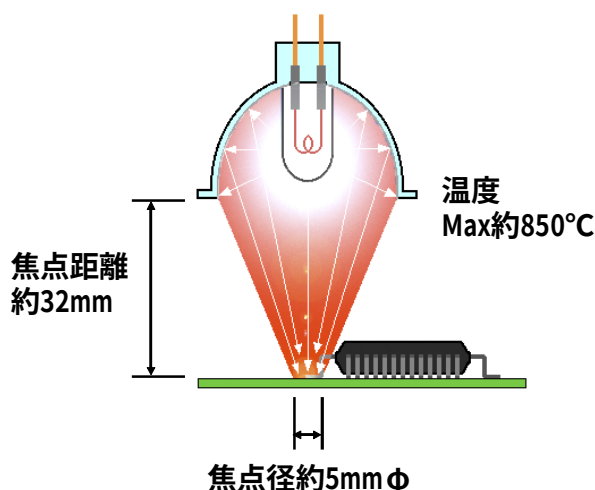




光ビームはんだ付け装置 LP-8150MK II

LP-8150MK IIはハロゲンランプを使用したリフローはんだ付け装置です。遠赤や熱風方式のように基板全体を加熱するのではなく、焦点(約5mmφ)だけを加熱します。

特長

- 150Wのハロゲンランプが出す近赤外線を反射鏡で集め、その焦点(直径約5mmのスポット)に約850℃の熱を集光します。
- 焦点以外は加熱しません。光ビームによる非接触加熱なのでクリーンな熱です。
- スイッチONで即、プリント基板なら約1秒で5mmφ範囲のはんだ付けができます。(クリームはんだ使用、チップ部品)
- 4φ石英ロッドレンズ(別売)を用いると、狭い(5mmφ)プラスチックボビンの中へもはんだ付けできます。(レンズ直下で約450℃)
- 発光(熱)出力は10~100%可変調節できます。
- ランプBOXは上下、前後、及び角度が自由に調節出来、ロボットアームなどへの別設置も簡単にできます。

仕様

・光(熱)源	: ハロゲンランプ 15V 150W(ミラー付き)
・焦点	: 焦点距離=約32mm 焦点径 = 約5mm 焦点温度=約850℃(熱電対による測定)
・光(熱)出力	: 150W(100~850℃) 10~100%可変調節
・照射時間	: モード切換スイッチによる NORMALモード START又はリモートスイッチのON時間 TIMERモード 0.1~10秒間(切換により1~100秒間)
・出力制御	: サイリスタによる波形位相制御
・リモートスイッチ	: A接点又はトランジスタ・スイッチ 5V 30mA
・電源	: AC100V/120V/220V/240V 150W 50/60Hz
・寸法・重量	: (W)230×(D)200×(H)300mm 約6.5kg

用途

- ・ハイブリッドICやSMT基板へのチップ部品やSOP-IC、LSIのはんだ付け。(クリームはんだを使用)
- ・チップ部品やSOP-IC(8~16pin)の取り外し(マスク使用)
- ・プラスチックモールドICやLSIのモールド除去。(発煙硝酸を使用、約10分で完全な状態のチップを露出できます。)

オプション

- ・ロッドレンズ(レンズホルダー付)
4φ×50mm石英ガラス
効率=約50%
- ・ハロゲンランプ(交換用、ミラー付)
- ・ホットマスク
- ・ヘッドアッセンブリー等スペアパーツはお問合わせ下さい。

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。